

MicroStar Series

Fully Automatic High Precision Die Bonder

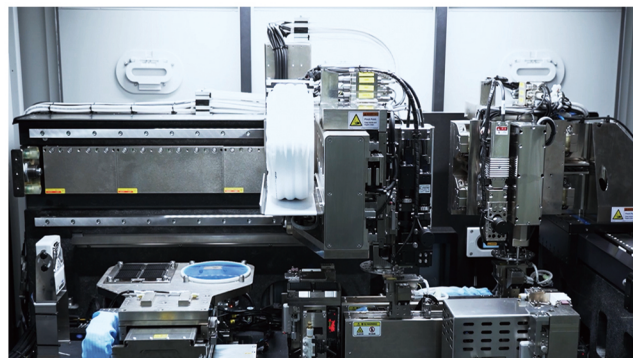
星威系列全自动高精度共晶机



Go tech! Go core!
让智慧改变芯未来

MicroStar Series Fully Automatic High Precision Die Bonder

星威系列全自动高精度共晶机



星威系列共晶机是高精度高效率的多功能芯片贴装设备。共晶贴片效率可达 15~35s/pcs, 贴片精度 $\pm 0.5 \sim \pm 3\mu\text{m}$ 。具备共晶贴片、蘸胶贴片及 Flip Chip 贴片功能, 可满足多芯片贴装需求。模块化的设计理念使其具备高柔性制造能力, 配备智能校准与数据管理系统, 使其具备工艺追溯与管理的能力。

应用行业

Application industries

5G 和数据通信、激光器、高精度 MEMS、医疗与生物光学、汽车、发光二极管、光学、功率半导体、射频、微波和天线、传感器、电信

设备特点

Product features

- **高精度**
贴装精度 $\pm 0.5 \sim \pm 3\mu\text{m}@3\sigma$, 贴装角度 $\pm 0.1 \sim 0.3^\circ$, 保证客户产品良率
- **高效率**
动态换刀, 双中转轴, 高效共晶台 (升温速率 $80^\circ\text{C}/\text{s}$, 340°C 至 200°C 降温时间 5s), 特定工况下可提升 20% 以上产出
- **高柔性**
多吸嘴自动更换, 多中转工位自由切换, 多种上料方式灵活选配
- **易扩展**
专有的客户编程界面(BOS), 可定制开发, 功能模块可选配

设备参数

Equipment specifications

■ 即将上市/In Development
■ 可选配置/Optional

产品型号		EF8621	EF9621	EH9721	EF7921	EG9921
贴装精度		±3μm@3σ	±3μm@3σ	±2μm@3σ	±0.5μm@3σ	±0.5μm@3σ
贴装角度		±0.3°	±0.3°	±0.3°	±0.1°	±0.1°
贴装工艺		共晶、蘸胶	共晶、蘸胶	共晶、蘸胶、 Flip Chip(选配)	共晶、蘸胶	共晶、蘸胶、 Flip Chip(选配)
设备应用		COC,COB,Gold-Box,COW,COS				
效率		15~25s/pcs (共晶, 依据具体应用)	15~25s/pcs (共晶, 依据具体应用)	15~25s/pcs (共晶, 依据具体应用)	手动工艺 (依据实际工况)	25s/pcs (共晶, 依据具体应用)
		5~7s/pcs (蘸胶, 依据具体应用)	5~7s/pcs (蘸胶, 依据具体应用)	5~7s/pcs (蘸胶, 依据具体应用)		5~7s/pcs (蘸胶, 依据具体应用)
贴装模块	吸嘴	12支, 动态换刀	12支, 动态换刀	12支, 动态换刀	手动换刀	动态换刀
	力控	(10~50g)±2g (50~300g)±2%	(10~50g)±2g (50~300g)±2%	(10~50g)±2g (50~300g)±2%	0.1~400N (闭环力控)	贴合过程闭环力控
移栽模块	吸嘴	12支, 动态换刀	12支, 动态换刀	/	/	12支, 动态换刀
	力控	(10~50g)±2g (50~300g)±3%	(10~50g)±2g (50~300g)±3%	/	/	(10~50g)±2g (50~300g)±3%
共晶模块	工作台	2	2	1	1	1
	中转台	单工作台MAX.8	单工作台MAX.8	单工作台MAX.8	单工作台MAX.8	单工作台MAX.8
	加热方式	脉冲加热	脉冲加热	脉冲加热	脉冲加热/贴头加热	激光加热
	温度范围	MAX.500°C	MAX.500°C	MAX.500°C	40~450°C	MAX.2000°C
	温升效率	50°C/S	50°C/S	50°C/S	50°C/S	400°C/S
供料模式	Wafer	6吋, 2个(最多)	6吋, 4个(最多)	6吋, 2个(最多)	/	6吋, 4个(最多)
	WafflePack Gel-Pak	2吋, 2个(最多)	2吋, 2个(最多)	2吋, 9个(最多)	2吋, 2个(最多)	2吋, 数量可定制
外形尺寸		1900*1100*1800mm	1900*1100*1800mm	1650*1100*1800mm	1900*1100*1800mm	1900*1100*1800mm
重量		MAX.2200KG	MAX.2200KG	MAX.2200KG	MAX.2200KG	MAX.2200KG
压缩空气		0.4-0.7Mpa	0.4-0.7Mpa	0.4-0.7Mpa	0.4-0.7Mpa	0.4-0.7Mpa
氮气		0.4-0.7Mpa	0.4-0.7Mpa	0.4-0.7Mpa	0.4-0.7Mpa	0.4-0.7Mpa
环境温度		23±2°C	23±2°C	23±2°C	23±2°C	23±2°C

以上图片及参数仅供参考, 实际以技术协议为准。

The pictures and parameters above are for reference, Final details will be reflected in our technical agreement.



博众半导体公众号



博众半导体视频号

公司总部:博众精工科技股份有限公司 (688097)

苏州博众半导体有限公司

地址:苏州市吴江经济开发区湖心西路666号

网址:www.bozemi.com

邮箱:semi.sales@bozhon.com

电话:0512-63414949-80512